

Höchste Qualität, die perfekt auf Kundenwünsche zugeschnitten ist

Highest quality, perfectly tailored to customer requirements

Die hervorragende Qualität der Almit-Lötpasten basiert auf strengsten und kleinschrittigen Qualitätskontrollen.

Die Zufriedenheit unserer Kunden steht für uns im Mittelpunkt. Deshalb bieten wir unseren Kunden nicht nur Lötzinn für höchste Ansprüche, sondern teilen auch gerne unser Know-how mit ihnen. **Wenn Sie eine Analyse Ihrer Lötstellen wünschen, können Sie gerne Kontakt mit uns aufnehmen!**

The best or nothing – The outstanding quality of Almit's solder pastes is based on strictest and incremental quality controls.

The satisfaction of our customers is our focus. That is why we not only offer our customers solder material for the highest demands, but are also pleased to share our expertise with them. If you would like to get an analysis of your solder joints, please feel free to contact us!



Viskosimeter / Viscometer



Bestücker / Mounter

1) Viskosimeter / Viscometer

Zur Ermittlung der dynamischen Viskosität.

To determine the dynamic viscosity. (cps)

2) Klebrigkeitstester / Tackiness Tester

Zur Ermittlung der Klebekraft von Lotpasten.

For determining the adhesive strength of solder pastes. (gf)

3) Drucker / Printer

Zur Ermittlung der optimalen Druckparameter.

To determine the optimum print parameters.

4) Bestücker / Mounter

Zum Bestücken der Bauteile.

To assemble the components.

5) Lötroboter (Kolben und Laser) / Robot soldering machine (iron+laser)

Zum Testen der Lötdrähte und Lötpasten (Selektive Lötprozesse).

For testing solder wires and solder pastes (selective soldering processes).

6) 3D Inspektionsmaschine / 3D inspection

Zur Ermittlung des Druckvolumens auf Leiterplatten.

For determining the print volume on printed circuit boards.

7) Reflow Simulator

Zur Visualisierung der Aufschmelzprozesse.

To visualise the melting processes.

8) Reflow Ofen / Reflow oven

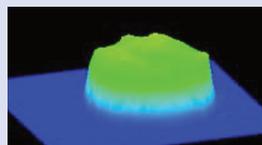
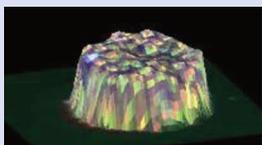
Für allgemeine Lötungen.

For general soldering.



3D Inspektionsmaschine / 3D Checker:

Zur Ermittlung des Druckvolumens auf Leiterplatten.
For determining the print volume on printed circuit boards



Reflow Simulator / Reflow simulator:

Zur Visualisierung der Aufschmelzprozesse (BGA-Kugel)
To visualise the melting processes (BGA ball)





1) Digitales Mikroskop / *Image observation*

Zur einfachen Begutachtung z. B. von Lötstellen
For easy inspection of e.g. solder joints.

2) Poliereinheit / *Cross section grinder*

Zur Vorbereitung der Proben zur metallurgischen Untersuchung.
To prepare the samples for metallurgical examination.

3) Klimaschrank / *Heat cycle*

4) Klimaschrank / *Heat shock*

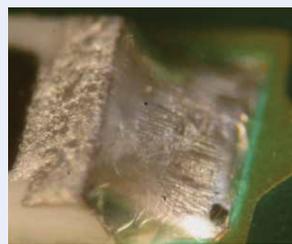
5) Klimaschrank / *Constant temperature humidity*

Zur Simulation von Alterungsprozessen, z. B. Wärmezyklentest.
For simulation of ageing processes, e.g. heat cycle test.

6) Scherrheometer / *Rheo meter*

Zur Ermittlung der Rheologie z. B. von Lötpasten
For determining the rheology of e.g. solder pastes.

Schliffbild / *Cross section image*



Klimaschrank / *Constant temperature humidity*



Klimaschrank / *Heat shock*

1) SEM/EDS

Rasterelektronenmikroskopie / Energiedispersive Röntgenspektroskopie (SEM/EDS) findet Verwendung bei der Analyse von Fehlerproblemen von Leiterplatten (PCBs), Baugruppen (PCAs) und elektronischen Bauteilen (BGA, Kondensatoren, Widerstände, Induktivitäten, Steckverbinder, Dioden, Oszillatoren, Übertrager, ICs usw.) Zur normalen optischen Mikroskopie liefert eine EDS Analyse halbquantitative Elementergebnisse über sehr spezifische Stellen.

Scanning Electron Microscopy / Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (SEM/EDS) is used in the analysis of failure problems of printed circuit boards (PCBs), assemblies (PCAs) and electronic components (BGA, capacitors, resistors, inductors, connectors, diodes, oscillators, transformers, ICs, etc.). For normal optical microscopy, an EDS analysis provides semi-quantitative element results over very specific locations.

2) EPMA

Als EPMA bezeichnet man ein analytisches Verfahren, mit dem die chemische Zusammensetzung kleiner Volumina fester Materialien zerstörungsfrei bestimmt wird.

EPMA is an analytical method for non-destructively determining the chemical composition of small volumes of solid materials.

3) Potentiometrische Titration / Potentiometric Titration

Die potentiometrische Titration ist eine Technik, die der direkten Titration einer Redoxreaktion ähnlich ist. Es ist ein nützliches Mittel zur Charakterisierung einer Säure.

Potentiometric titration is a technique similar to the direct titration of a redox reaction. It is a useful tool for characterising an acid.

4) Massenspektrometer / Mass Spectrometer

Massenspektrometrie bezeichnet ein Verfahren zum Messen der Masse von Atomen oder Molekülen. Die zu untersuchenden Moleküle werden dabei in die Gasphase überführt und ionisiert. *Mass spectrometry is a method for measuring the mass of atoms or molecules. The molecules to be examined are transferred into the gas phase and ionised.*

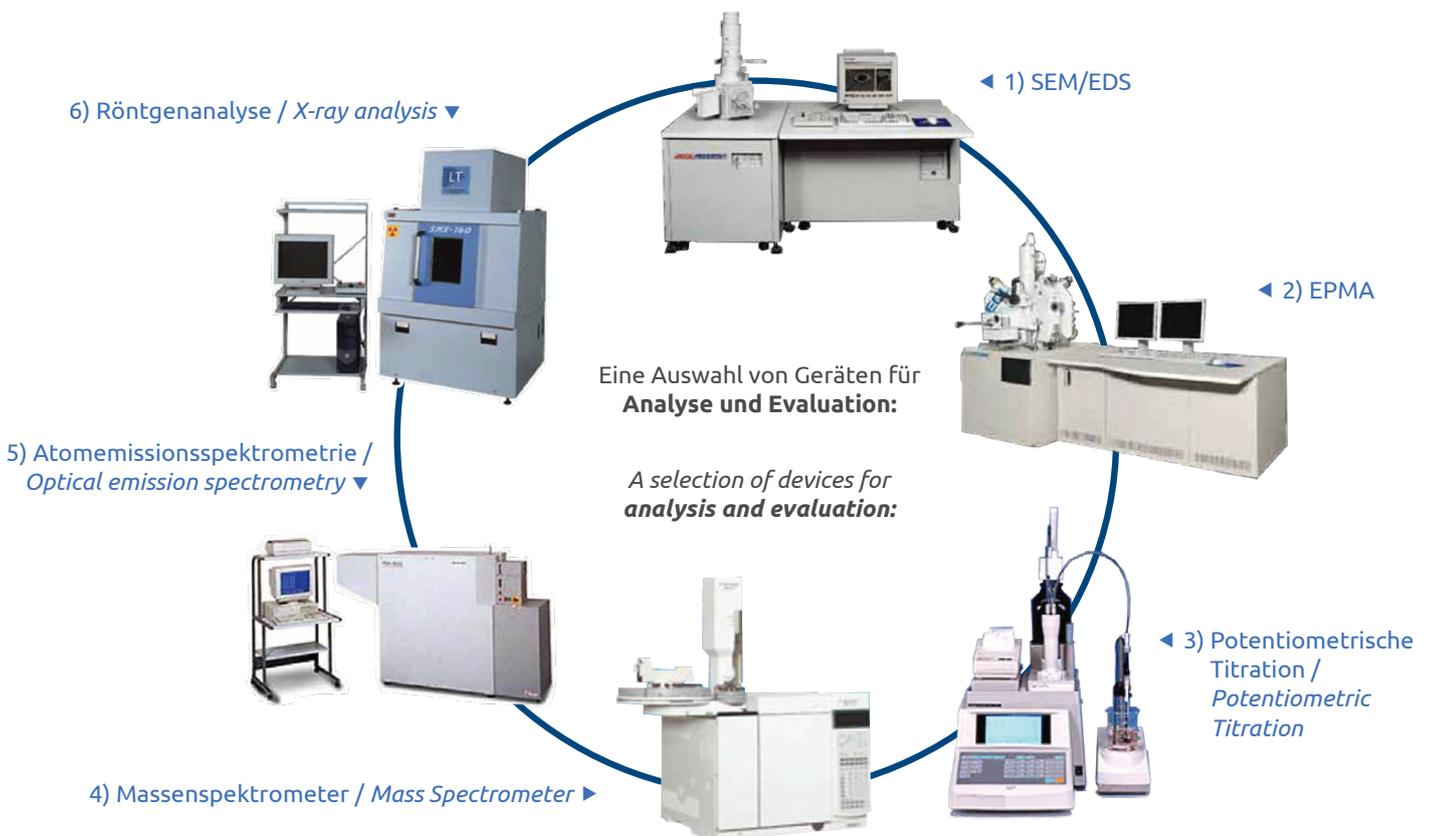
5) Atomemissionsspektrometrie / Optical emission spectrometry

Elementaranalyse von festen Metallproben, unentbehrlich für die Qualitätskontrolle.

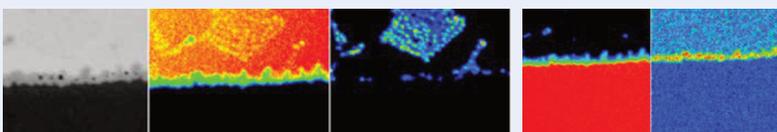
Elemental analysis of solid metal samples, indispensable for quality control.

6) Röntgenanalyse / X-ray analysis

Zur Untersuchung von Bauelementen und Ermittlung der Lunkerbildung. *For the examination of components and determination of voids.*



EPMA Abbildung einer Lötstelle / EPMA mapping of a solder joint



Röntgenaufnahme eines Chips / X-ray image of a chip

